

2026년판

KERC SUPPORTERS

# 유럽 주요 분야별 연구 및 정책 동향



# [2025 하반기] 유럽 반도체 및 디스플레이 연구 · 정책 동향

<작성자: 황현정>

## <요약>

유럽은 2025년 9월 이후 Chips JU·Digital Europe·EIB를 중심으로 반도체·디스플레이 연구 투자를 한 단계 세분화·고도화하고 있다. Chips Joint Undertaking의 2026년 공모는 전력전자, 포토닉스, 헬스케어, 소프트웨어 정의 차량(SDV), 양자칩, lab-to-fab 가속기, 설계·스킬 허브 등으로 과제를 나누어, 기존의 포괄적 지원에서 응용 분야별 병목을 겨냥하는 타깃형 R&I 구조로 전환하고 있다.

동시에 Open EU Foundry(OEF)와 Integrated Production Facility(IPF) 제도를 통해 ESMC, ams-OSRAM 같은 생산 시설에 전략적 지위를 부여함으로써, 특정 팹·라인을 EU 공급망의 핵심 인프라로 지정하고 행정 지원·위기 시 의무를 제도화하는 새로운 거버넌스가 도입되었다.

금융 측면에서는 유럽투자은행(EIB)이 177억 유로 규모의 패키지 중 42억 유로를 TechEU 하에 혁신·반도체·에너지 관련 프로젝트에 배분해, 고금리 환경에서도 대규모 Fab·패키징·테스트 투자를 가능하게 하는 장기 자본을 공급하고 있다.

Digital Europe Programme의 중간평가는 HPC, AI, 사이버보안, EDIH, 반도체 파일럿·컴퓨터스센터를 EU 경쟁력 의제의 핵심 이행 수단으로 재확인해, 반도체·디스플레이 R&I를 디지털 인프라·인력 정책과 통합된 구조 속에서 위치시킨다.

디스플레이 분야에서는 유럽 OLED 마이크로디스플레이 시장이 2024년 약 3.8억 달러에서 2032년 16억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, MicroLED·무반사(reflection-free) 디스플레이도 AR/VR, 의료, 산업, 스마트시티, 자동차용 등 고부가 세그먼트에서 빠르게 부상해, 유럽이 대량 패널 생산이 아니라 고부가·니치 시장 중심의 기술·응용 허브로 자리 잡아가는 흐름이 뚜렷하다.

<Key words> Chips JU 응용 세분화, OEF·IPF 전략 팹, EIB TechEU 금융, Digital Europe 경쟁력, OLED 마이크로디스플레이·무반사 디스플레이

## I. 유럽의 반도체 및 디스플레이 연구 동향

### □ Chips JU 2026 공모 구조와 연구 축 재편<sup>1)</sup>

#### ○ ECS R&I Calls 2026 - 응용축의 세분화

- 노르웨이 연구위원회가 2026년 2월 공지한 ‘Chips EU-calls within semiconductor technologies in 2026’은 Chips Joint Undertaking(Chips JU)이 2026년에 개시할 연구·혁신 공모 구조를 체계적으로 정리 진행 하였으며, 주요 특징으로는 다음과 같이 발표:

① GLOBAL IA – HORIZON-JU-CHIPS-2026-1-IA: 예산 4,000만 유로, 글로벌 협력형 혁신행동(IA)을 통해 유럽 반도체 기술 전반의 경쟁력 강화가 목표

② Reinforcing Europe’s Strength in Power Electronics – HORIZON-JU-CHIPS-2026-FT1-IA: 2,000만 유로 규모로, 전력전자(특히 차량·에너지·산업용)에서 유럽의 강점을 강화하는 프로젝트 지원

③ AI-assisted methods and tools for Software-Defined Vehicle Engineering Automation – FT4-IA: 2,000만 유로 규모로, 소프트웨어 정의 차량(SDV) 공학 자동화용 AI 기반 도구 개발 지원

- 이는 2025년 상반기까지 상대적으로 포괄적으로 정의되었던 Chips JU R&I 축이, 2025년 하반기~2026년 초에 전력전자·포토닉스·헬스·자동차(SDV)를 중심으로 보다 명확한 응용축으로 재편되고 있음을 보여줌

#### ○ Chips for Europe - Lab-to-Fab, Quantum, Skills 공모

- 동일 문서는 Chips for Europe 이니셔티브 하에 2026년에 시행될 ‘핵심 역량 구축’ 공모 제시
- Lab to Fab Accelerator - DIGITAL-JU-CHIPS-2025-SG-LFA: 2026년 5월 7일 마감 예정으로, 연구실 수준 기술을 산업 파일럿·양산 단계로 전이 하는 lab-to-fab 가속 목표 (예산 5,000만 유로)
- Quantum Chips Design - HORIZON-JU-CHIPS-2026-QUANTUM-1-RIA (3,000만 유로) 및 Quantum Chips: Enabling Technologies - QUANTUM-2-RIA (2,000만 유로): 양자칩 설계와 이를 뒷받침하는 공정·재료·패키징·제어 기술 개발 지원

1) <https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/International-joint-calls/chips-eu-calls-within-technologies-2026/>

- Skills Hubs of Excellence (2,000만 유로), Pilot Federation (1,000만 유로), Stimulation of Chip Design (1,500만 유로) 등 반도체 설계·인력 양성·스킬 허브 구축 공모 포함
- 이러한 공모 구조는 최근 6개월 사이 EU가 반도체 R&I 정책에서 (1) 응용 분야(전력전자·포토닉스·헬스·자동차)를 정교하게 타기팅하고, (2) 양자칩·lab-to-fab·설계·스킬 허브를 통합한 생태계 강화를 중점 과제로 설정함을 시사

## □ OEF · IPF 제도 도입과 제조 역량 강화<sup>2)</sup>

### ○ OEF·IPF 제도의 주요 내용

- 2025년 10월, 유럽집행위는 Chips Act 하에서 새롭게 도입된 Open EU Foundry(OEF) 및 Integrated Production Facility(IPF) 제도를 처음으로 적용하고, 일부 프로젝트에 IPF·OEF 지위를 부여
- OEF(Open EU Foundry): 외부 고객용 생산능력을 일정 부분 개방하는 first-of-a-kind 제조 시설로, 위탁생산을 통해 공급망 복원력 확보에 기여하는 시설에 부여
- IPF(Integrated Production Facility): 설계·제조·테스트·패키징을 통합하는 수직 계열 제조 시설로, 내부·외부 수요를 동시에 충족할 수 있는 전략적 생산 시설로 정의
- 해당 지위를 부여받은 시설은 행정 절차 간소화·허가 우선 처리·과일릿 라인 우선 접근 등의 혜택을 받는 동시에 위기 시 '위기 관련 주문(priority-rated orders)'을 우선 수행해야 하는 의무를 부담

### ○ ESMC 및 Ams OSRAM 사례

- ESMC, 독일(드레스덴) - OEF: TSMC, Bosch, Infineon, NXP가 설립한 합작법인으로, 300mm FinFET 기술(28/22nm, 16/12nm)을 활용해 연간 48만 장 규모의 웨이퍼 생산 계획
- Ams OSRAM, 오스트리아 - IPF: 180nm 혼성신호(mixed signal) 공정을 포함한 전방공정을 구축해, 센서·광전자 소자 등 고부가 응용을 위한 수직 계열 생산 시설로 기능하도록 설계

2) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/milestone-strengthening-europes-semiconductor-manufacturing-capacity-under-chips-act-reached>

- 이는 기존 보고서에서 다뤄지던 투자·보조금 승인(예: ESMC 합작투자)과 달리 최근 6개월 내에 생산 시설의 '전략적 지위'를 제도적으로 규정하고 집행한 첫 사례로, Chips Act 이행이 선언·계획 수준을 넘어 집행·운영 단계로 진입했음을 시사

## □ EIB 177억 유로 금융 패키지와 반도체 지원

### ○ TechEU를 통한 반도체·혁신 금융

- 유럽투자은행(EIB) 그룹은 2025년 11월 이사회에서 총 177억 유로 규모의 금융 패키지를 승인함. 이 중 42억 유로는 TechEU 프로그램 하에서 혁신 기업·기술을 지원하는 데 배정되며, 반도체 제조와 배터리 저장, 전략 인프라가 주요 수혜 분야로 대두됨<sup>3)4)</sup>
- 보도 자료는 해당 패키지가 EU 내 반도체 제조 혁신 프로젝트를 포함하여 에너지 인프라·철도·사회 인프라 등 광범위한 분야의 경쟁력·회복력 제고를 목표로 한다고 명시함. EIB 그룹은 2024년 한 해 동안 900개 이상의 프로젝트에 약 890억 유로를 공급했으며, 이 중 약 60%가 기후·환경 관련 투자
- EIB의 177억 유로 패키지는 직접적인 반도체 수치(개별 프로젝트 금액)는 공개하지 않지만, TechEU를 통해 EU 내에서 개발된 기술·기업이 유럽 안에서 성장할 수 있도록 하는 장기·대규모 금융 백스톱이라는 점에서 Chips Act·IPCEI와 다른 차원의 정책 도구로서 기능함. 특히 고금리 환경에서 대규모 펌·패키징·테스트 투자를 위한 자본비용을 낮춘다는 점에서 2025.9~2026.3 기간의 중요한 거시적 변화로 평가

## □ Digital Europe 프로그램 중간평가와 반도체 파일럿·컴피턴스센터

### ○ DIGITAL 프로그램 성과 (2025.12.18 기준)<sup>5)</sup>

- Digital Europe Programme(DIGITAL)은 고성능 컴퓨팅(HPC), AI, 사이버 보안, 고급 디지털 스킬, 디지털 기술 보급 등 EU 전략 디지털 역량을 구축하는 데 초점을 둔 프로그램

3) <https://www.eib.org/en/press/all/2025-463-eib-group-endorses-eur17-7-billion-of-support-for-semiconductors-green-transition-energy-networks-and-social-housing>

4) <https://www.electronicsspecifier.com/news/eib-backs-e17-7bn-for-semiconductors-green-transition-energy/>

5) <https://dedep.eu/news/how-eus-competitiveness-agenda-reinforcing-digital-europe-programme-2026>

- 2025년 12월 18일 발표된 중간평가·성과 스냅샷은 다음과 같은 정량적 성과를 제시
- JUPITER(유럽 최초 엑사스케일 슈퍼컴퓨터) 구축 - TOP 500 순위 4위 진입
- 4개의 대규모 부문별 AI 시험·실험(Testing and Experimentation Facilities) 구축
- 150개 이상 European Digital Innovation Hubs(EDIH)를 90%의 EU 지역에 배치, 5만 4,600개 기업에 2만 9,000개 이상의 서비스를 제공
- 고급 디지털 분야에서 2만 700명 이상 교육·훈련, 26개 CyberHub 조달, 27개 국가 사이버보안 조정센터 설립
- 반도체 파일럿라인 및 컴퍼턴스센터에 대한 유의미한 투자가 진행 중임을 명시

### ○ 경쟁력 의제와의 연계

- 동 평가를 해설한 기사에 따르면, 2026년 초 EU 경쟁력 논의에서 DIGITAL 프로그램이 “경쟁력 전략의 핵심 이행 수단(core implementation instrument)”으로 자리매김하고 있으며, 반도체 파일럿라인 및 컴퍼턴스센터에 대한 투자는 단순 산업정책을 넘어 경제 회복력·디지털 인프라·고급 인력 양성과의 직결임을 강조
- 이는 최근 6개월간 반도체·디스플레이 연구 동향을 볼 때, 개별 기술 프로젝트뿐 아니라 디지털·HPC·AI 인프라와 통합된 구조로 R&I가 설계되고 있음을 보여주는 거시적 배경

## □ 첨단 패키징 및 공급망 동향(시장 · 정책 결합)

### ○ 유럽 첨단 패키징 시장 - 두 가지 추정치

- Mobility Foresights(2025.9): 유럽 첨단 패키징 시장을 2025년 435억 달러, 2031년 782억 달러로 추정하며 연평균 10.2% 성장 전망<sup>6)</sup>
- Grand View Research 자회사 플랫폼 ‘Horizon’(2022.12, 2024년 기준 데이터 업데이트): 유럽 첨단 패키징 시장 매출을 2024년 기준 91억 9,390만 달러로 추산하고, 2025~2030년 연평균 5.5% 성장해 2030년 126억 1,830만 달러에 이를 것으로 제시<sup>7)</sup>

6) <https://mobilityforesights.com/product/europe-advanced-semiconductor-packaging-market>

7) <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/advanced-packaging-market/europe>

- 또한 2025년 11월 발표된 LinkedIn 차트 분석은 유럽 첨단 패키징 시장 가치를 2025년 121억 5,000만 달러, 2026~2033년 연평균 10.46% 성장, 2033년 220억 7,000만 달러 수준 추정<sup>8)</sup>
- 수치 간 편차는 크지만 공통적으로 (1) 유럽 첨단 패키징 시장의 고성장, (2) 글로벌시장에서 유럽 점유율이 20~30%대로 상당한 비중을 차지한다는 점을 시사

### ○ 기술·응용 측면 변화

- 최근 분석들은 2.5D/3D, 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FOWLP), 시스템 인패키지(SiP) 등 첨단 패키징 기술이 자동차(ADAS/EV), 5G, AI/HPC, IoT 수요와 결합되어 시장을 견인하고 있다고 공통적으로 평가<sup>9)</sup>
- 유럽은 자동차·산업용 전자에서 강점을 바탕으로, 고신뢰·고 온도안정성·장수명 요구가 큰 응용에 특화된 패키징 기술(예: 고온용 전력 모듈, 산업용 SiP, 신뢰성 중심 설계)을 발전시키고 있으며, 이는 Chips JU의 전력전자·포토닉스 공모와도 방향성 일치

## II. 유럽의 반도체 및 디스플레이 정책 동향

### □ 유럽 OLED 마이크로디스플레이 시장: 고성장과 리스크 인식<sup>10)11)</sup>

#### ○ 시장 규모·전망(2024~2032)

- 2025년 10~11월 발표된 유럽 OLED 마이크로디스플레이 시장 분석에 따르면, 유럽 OLED 마이크로디스플레이 시장은 2024년 약 3억 8,000만 달러 규모로 평가. 2025~2032년 연평균 약 20% 성장하여 2032년 약 16억 달러 수준에 도달할 것으로 전망
- 주된 성장 동력은 AR/VR·MR 헤드셋, 스마트 글래스, 군·산업·의료용 HMD(Head-Mounted Display)의 확산

8) <https://www.linkedin.com/pulse/europe-advanced-semiconductor-packaging-market-chart-dzo5e/>

9) <https://www.researchandmarkets.com/reports/6053242/europe-advanced-packaging-market-size-share-and>

10) <https://www.linkedin.com/pulse/europe-oled-microdisplay-market-overview-2025-comprehensive-a6toe/>

11) <https://www.hdinresearch.com/news/772>

- 고해상 전자식 뷰파인더(EVF), 의료 영상 장비, 열영상 카메라, 군수·보안 장비 등 전문·산업용 마이크로디스플레이 수요도 성장세에 크게 기여할 것으로 분석

## □ 최근 6개월 분석에서 부각된 리스크 요인

### ○ 리스크·제약 요인

- (고비용 제조 구조) 실리콘 백플레인과 정밀한 유기 물질 증착 공정 등으로 인해 생산 단가가 높고 수율 관리가 어려워 대량 상용화에 제약이 존재한다는 점을 반복적으로 지적
- (공급망 집중도) 특수 소재·장비 공급업체가 소수에 집중되어 있어 지정학·무역 규제·공급 차질에 취약
- (관세·통상 리스크) 일부 보고서는 관세·무역 갈등이 OLED 마이크로디스플레이 공급망을 단편화하고 비용을 상승시켜 유럽 내 생산 기반 구축 또는 공급선 다변화 압력을 높일 것이라고 분석
- 해당 논의는 유럽이 단순히 '성장 시장'으로서가 아니라 공급망 리스크 관리와 전략적 생산 거점 확보 관점에서 OLED 마이크로디스플레이를 바라보기 시작했음을 시사

## □ MicroLED 및 관련 디스플레이 시장

### ○ MicroLED - 유럽 시장 전망

- 유럽 Micro-LED 시장은 AR/VR, 대형 디지털 사이니지, 자동차 HUD, 웨어러블 등에서의 고휘도·고효율 요구에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상
- 공개 리포트 일부는 2030년까지 유럽 MicroLED 시장이 수십억 달러 규모에 도달할 것으로 예상하면서, 생산원가·수율·레드 픽셀 효율을 핵심 과제로 지적<sup>12)</sup>
- MicroLED는 고휘도·고명암비·장수명이라는 장점에도 불구하고 대량 전사 공정·불량 픽셀 복구(repair)·칩 크기 축소(10  $\mu\text{m}$  이하)에서 비용·기술 난제 지속

12) <https://www.researchandmarkets.com/report/europe-microled-market>

- 유럽의 대규모 생산 팩 비중은 낮지만, AR/VR용 LEDoS(LED-on-Silicon) 구조, 광학 설계, 헤드업 디스플레이 모듈과 같이 가치 사슬 상류·시스템 통합 영역에서 역할을 확대하는 전략 채택

## □ Reflection-free(무반사) 디스플레이 시장 - 안구 피로·야외 가시성 이슈 대응

### ○ 반사 저감·무반사 디스플레이 유럽 시장 전망

- 2월 HDIN Research는 Reflection-free Display Market Forecast 2026 분석을 통해, 반사 저감·무반사 디스플레이 시장이 2026년 59억~97억 달러 규모로 형성될 것으로 추정<sup>13)</sup>
- 2026~2031년 예상 연평균 성장률은 8.5~12.4%로, 일반 디스플레이 시장 대비 높은 성장세 예상
- 기술적으로는 나노 텍스처 표면 처리와 다층 반사 방지(AR) 코팅을 결합해 반사율을 2% 이하로 낮출 수 있는 솔루션을 핵심으로 제시
- 주요 응용은 전자 선반 라벨(ESL), 옥외 디지털 사이니지, 스마트시티 키오스크, 자동차 계기판·인포테인먼트 패널 등으로, 밝은 환경에서의 가독성·시인성이 중요한 세그먼트로 인식
- 다른 시장 분석은 전자책 리더, ESL, 고휘도 디지털 사이니지 수요를 바탕으로 반사 저감 디스플레이 시장이 2025년 125억 달러 규모, 2033년까지 연평균 8.5% 성장할 것으로 제시<sup>14)</sup>
- 유럽의 대형 패널 생산기지로서의 비중은 상대적으로 낮지만, 의료·산업용·스마트시티·교통 인프라용 디스플레이에서 무반사·고가독성 요구가 크다는 점에서 해당 세그먼트에서 장기적인 수요·프로젝트 기회 확대 예상

## □ 글로벌 디스플레이 기술·시장과의 접점

### ○ OLED 마이크로디스플레이 - 글로벌 관점<sup>15)</sup><sup>16)</sup><sup>17)</sup>

- 글로벌 OLED 마이크로디스플레이 시장은 2025년 18억 8,000만 달러에서

13) <https://www.hdinresearch.com/reports/159998>

14) <https://www.marketreportanalytics.com/reports/reflection-free-display-378146>

15) <https://www.linkedin.com/pulse/2026-europe-oled-microdisplay-market-risks-challenges-m3tje/>

16) <https://www.skyquestt.com/report/oled-microdisplay-market>

17) <https://www.linkedin.com/pulse/challenges-opportunities-microdisplays-jjltf/>

- 2033년 114억 2,000만 달러로 연평균 25.3% 성장할 것이라는 전망 제시
- 유럽 시장은 이 중 고부가 AR/VR·의료·산업용 세그먼트에서 높은 비중을 차지하며, 자동차 HUD·항공·군수용 HMD 등 특수 응용에서도 성장 예상
  - AR/VR·HMD, 전자식 뷰파인더, 군용·산업용 디스플레이 등 고성장 세그먼트에서 유럽 기업·연구기관의 R&D 파이프라인이 두드러지도록 확대
  - 다만, 제조 비용, 공급망 집중, 관세 등 리스크가 동반되므로, 유럽 내 생산 기지 및 공급선 다변화가 핵심 과제로 부각

## □ Microdisplay 전반 - 통합 시장 관점

### ○ 유럽 통합 시장 분석

- 2026년 2월자 글로벌 마이크로디스플레이 분석은 마이크로디스플레이 시장이 2025년 50억 달러 수준까지 확대될 수 있다고 보면서, OLED·MicroLED·LCoS 등 다양한 기술이 AR/VR·MR·HUD·웨어러블에서 경쟁·보완 관계를 형성할 것으로 전망
- 이는 유럽의 OLED 마이크로디스플레이·MicroLED·반사 저감 디스플레이 연구가 단일 기술 독점이 아닌 멀티 플랫폼 경쟁 환경에서 위치를 잡아야 함을 시사

## III. 시사점

### □ ECA 특별보고서(12/2025)의 함의

#### ○ 주요 평가<sup>18)</sup>

- 유럽회계감사원(ECA)의 Special Report 12/2025 - The EU's strategy for microchips는 Chips Act 전략에 대한 최초의 포괄적 외부 평가로, 2025년 9~12월 정책 논의에 큰 영향 행사
- 2030년까지 글로벌 시장점유율 20% 목표는 “매우 야심적”이며 현 추세(11.7% 예상치)로는 도달에 한계가 있음
- Chips Act를 통해 동원될 수 있는 공공·민간 투자 규모는 글로벌 주요 기업들의 설비투자 계획과 비교할 때 여전히 규모·속도 측면에서

18) [https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-12/SR-2025-12\\_EN.pdf](https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2025-12/SR-2025-12_EN.pdf)

### 불충분함

- 반도체 관련 EU 투자·국가 보조는 Horizon Europe, 구조 기금, InvestEU, EIB 등 여러 수단으로 분산되어 있으며, 집행위가 전체를 조정·모니터링 할 충분한 권한·데이터를 보유 부족
- ECA는 전략의 현실성 재점검(Reality Check), 명확한 중간목표·KPI 설정, 정기 모니터링 및 장애요인 조기 발견 메커니즘 구축, 국가 보조·IPCEI 집행에 대한 투명성·거버넌스 강화 등을 권고

## □ Chips Act 투자 모멘텀에 대한 평가(언론 · 분석)

### ○ 주요 평가

- Science | Business 등은 2026년 2월 기사에서 Chips Act가 유럽 내 대규모 반도체 투자(ESMC, Infineon MEGAFAB-DD, STMicroelectronics ·GlobalFoundries 확장 등)를 촉진했으나, 법 개정(Chips Act 2.0)을 앞둔 상황에서 여전히 더 많은 투자·정책 조정이 필요하다고 평가<sup>19)</sup>
- 링크드인 등 민간 분석 역시 2025~26년 초 ESMC에 대한 50억 유로 규모 독일 국가 보조 승인, Infineon MEGAFAB-DD에 대한 9억 2,000만 유로 국가 보조 승인 등을 언급하며, 국가 보조·Chips Act가 대규모 칩 투자 실현에 핵심 역할을 했다고 분석<sup>20)</sup>

## □ Digital Europe - 경쟁력 의제와의 통합<sup>21)</sup>

### ○ 주요 평가

- 앞서 살펴본 DIGITAL 중간평가와 이를 해설한 기사들은 2026년 초 EU 경쟁력·산업정책 논의에서 DIGITAL 프로그램이 핵심 수단으로의 자리매김을 강조
- HPC, AI, 사이버보안, 스킬, EDIH 네트워크 등은 반도체·디스플레이 산업의 수요·활용 측면과 직접 연결
- DIGITAL 프로그램은 Chips Act의 Pillar I(연구·파일럿·컴피턴스센터)와 중첩되는 영역을 갖고 있으며, 반도체 파일럿라인·컴피턴스센터에 대한 DIGITAL 재원이 경쟁력 의제의 일부로 재정렬

19) <https://sciencebusiness.net/news/semiconductors/chips-act-spurs-semiconductor-investments-europe>  
 20) <https://www.linkedin.com/pulse/europes-semiconductor-momentum-2025-26-strategic-investments-nwu8e/>  
 21) <https://dedep.eu/news/how-eus-competitiveness-agenda-reinforcing-digital-europe-programme-2026>

- 이는 최근 6개월간 유럽이 반도체를 단독 산업이 아니라 디지털 인프라 전체와 통합된 전략 자산으로 다루고 있음을 시사

## □ 종합 평가 및 한국 측 시사점

### ○ 기술·연구 측면 요약

- (연구 축의 세분화와 응용 지향성 강화) Chips JU 2026 공모는 전력 전자, 포토닉스, 헬스, SDV, 양자칩, lab-to-fab, 설계·스킬 등으로 연구 축을 세분화하여, 기존의 포괄적 R&I에서 응용·생태계 병목 지점을 겨냥한 타기팅 전략으로 전환<sup>22)</sup>
- (제조 인프라의 전략적 지위 제도화) OEF/IPF 제도 도입과 ESMC·ams-OSRAM 지정은, 특정 제조 시설을 전략 인프라로 규정하고, 우선 지원·우선 의무를 동시에 부여하는 새로운 거버넌스 메커니즘을 도입한 사례
- (첨단 패키징·디스플레이 고부가 세그먼트의 부상) 첨단 패키징 시장에서 유럽은 2024년 기준 91.9억 달러(글로벌 23.2% 비중) 또는 2025년 121억 5,000만 달러 수준의 시장을 형성하고 있으며, 2025~2033년 4~10%대의 성장률 예상
- 디스플레이에서는 OLED 마이크로디스플레이, MicroLED, 무반사 디스플레이 등에서 고부가·니치 마켓 중심으로 유럽 수요와 연구 확대

## □ 산업·정책 환경 시사점

### ○ Chips Act 2.0/개정 논의를 전제로 한 전략 재편

- ECA 보고서·Science|Business 기사 등은 20% 목표의 비현실성과 투자·거버넌스 한계를 지적하면서 차기 반도체 전략(Chips Act 2.0)을 위한 현실적 재설계 필요성 제기
- 한국은 향후 Chips Act 개정 과정에서 설계·패키징·공급망·ESG·디스플레이·디바이스 등 세부 영역별 규범·프로그램 재편이 예정되어 있음을 감안할 때 관련 협력·규제 대응 전략의 선제적 준비가 필요

### ○ EIB·TechEU·DIGITAL의 '재정·디지털 인프라' 결합 구조

- 반도체·디스플레이 관련 대규모 프로젝트는 이제 Chips Act·IPCEI·국가

22) <https://www.forskningradet.no/en/call-for-proposals/International-joint-calls/chips-eu-calls-within-technologies-2026/>

보조 + EIB·TechEU + DIGITAL/Horizon의 복합 재원 구조로 추진되는  
경향 강력

- 이는 프로젝트 참여·투자 시 단일 프로그램 대응을 넘어, 복수의 EU  
금융·R&I·디지털 인프라 프로그램을 결합한 구조 설계 능력이 중요성  
증가의 의미 보유

## □ 한국(정부·기업·연구기관) 시사점

### ○ 첨단 패키징·전력전자·포토닉스 협력

- 유럽 첨단 패키징 시장의 성장과 Chips JU의 전력전자·포토닉스 공모는  
한국의 HBM·전력반도체·광통신·이미징 기술과의 공동 연구·파일릿  
생산 기회 제공
- 특히 EV·ADAS·재생에너지·산업 자동화 분야에서, 한 - 유럽 공동  
패키징·모듈 플랫폼을 개발해 글로벌 OEM·티어1에 공동 제안하는  
전략 모색

### ○ OLED 마이크로디스플레이·무반사 디스플레이의 고부가 세그먼트 공략

- 유럽 OLED 마이크로디스플레이 시장의 고성장과 무반사 디스플레이 시장  
확대는 한국 디스플레이 기업·소재·장비 업체에 AR/VR·의료·산업용·  
스마트시티용 고부가 세그먼트에서의 협력 기회 제공
- 한국은 대형 패널·OLED·MicroLED 제조 역량을, 유럽은 의료·산업·  
모빌리티·공공 인프라 수요 및 규제·표준화를 강점으로 보유하고 있어,  
“한국 제조+유럽 응용·규제” 결합형 비즈니스 모델 설계 가능성 주목

### ○ 정책·표준·ESG 연계 전략

- 반도체·디스플레이 R&I 과제의 설계 단계에서부터 에너지 효율, 탄소  
발자국, 유해 물질(PFAS 등) 규제, 순환 경제 요소를 반영하는 것이  
EU 프로그램 참여 및 시장 진입에 점점 더 필수 요건으로 대두
- 한국 정부·기업은 Chips Act 개정, DIGITAL·Horizon 워크프로그램,  
디스플레이·반도체 관련 환경·제품 규제(무반사 코팅, 안구 피로 기준  
등)의 변화를 모니터링하면서, 한 - EU 디지털 파트너십·공동 공모·  
표준화 포럼 등을 통해 협력과 규범 형성에 동시에 참여하는 이중  
전략을 추진할 필요성을 제시